



**PATENT APPLICATION**

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

re the Application of

Eigo NAKAGAWA et al.

Application No.: 10/721,461

Filed: November 26, 2003

Docket No.: 117863

For: CIRCUIT BOARD INSPECTION DEVICE

**CLAIM FOR PRIORITY**

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

The benefit of the filing dates of the following prior foreign applications filed in the following foreign countries is hereby requested for the above-identified patent application and the priority provided in 35 U.S.C. §119 is hereby claimed:

Japanese Patent Application No. 2002-367791 filed December 19, 2002;

Japanese Patent Application No. 2002-369283 filed December 20, 2002;

Japanese Patent Application No. 2003-177697 filed June 23, 2003

In support of this claim, certified copies of said original foreign applications:

are filed herewith.

It is requested that the file of this application be marked to indicate that the requirements of 35 U.S.C. §119 have been fulfilled and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of these documents.

Respectfully submitted,

James A. Oliff  
Registration No. 27,075

Thomas J. Pardini  
Registration No. 30,411

JAO:TJP/tje

Date: February 26, 2004

**OLIFF & BERRIDGE, PLC**  
**P.O. Box 19928**  
**Alexandria, Virginia 22320**  
**Telephone: (703) 836-6400**

DEPOSIT ACCOUNT USE  
AUTHORIZATION  
Please grant any extension  
necessary for entry;  
Charge any fee due to our  
Deposit Account No. 15-0461

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2002年12月19日  
Date of Application:

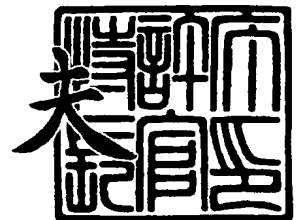
出願番号 特願2002-367791  
Application Number:  
[ST. 10/C]: [JP 2002-367791]

出願人 富士ゼロックス株式会社  
Applicant(s):

2004年 1月 9日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今井 康



【書類名】 特許願

【整理番号】 FE02-01501

【提出日】 平成14年12月19日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 G01R 31/00

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県足柄上郡中井町境430 グリーンテクなかい  
富士ゼロックス株式会社内

【氏名】 中川 英悟

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県足柄上郡中井町境430 グリーンテクなかい  
富士ゼロックス株式会社内

【氏名】 足立 康二

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県足柄上郡中井町境430 グリーンテクなかい  
富士ゼロックス株式会社内

【氏名】 安川 薫

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県足柄上郡中井町境430 グリーンテクなかい  
富士ゼロックス株式会社内

【氏名】 山田 紀一

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県足柄上郡中井町境430 グリーンテクなかい  
富士ゼロックス株式会社内

【氏名】 上床 弘毅

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県足柄上郡中井町境430 グリーンテクなかい  
富士ゼロックス株式会社内

【氏名】 里永 哲一

## 【特許出願人】

【識別番号】 000005496

【氏名又は名称】 富士ゼロックス株式会社

## 【代理人】

【識別番号】 100086298

【弁理士】

【氏名又は名称】 船橋 國則

【電話番号】 046-228-9850

## 【手数料の表示】

【予納台帳番号】 007364

【納付金額】 21,000円

## 【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 回路基板検査装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 所定の部品や配線が形成されて成る回路基板の動作を検査する回路基板検査装置において、

前記回路基板の部品実装面と略平行に配置される支持基板と、

前記支持基板が前記回路基板と略平行に配置された状態で、前記支持基板における前記回路基板の部品もしくは配線と対応する位置に配置される信号変化検出手段と

を備えることを特徴とする回路基板検査装置。

【請求項 2】 前記信号変化検出手段は、前記部品を流れる電流から発生する磁界によって誘導起電力を発生するコイルを有する

ことを特徴とする請求項 1 記載の回路基板検査装置。

【請求項 3】 前記信号変化検出手段は、前記配線を流れる信号変化によって電位情報を生じさせるインピーダンス成分を有する

ことを特徴とする請求項 1 記載の回路基板検査装置。

【請求項 4】 前記支持基板は可撓性を有する薄型基板から成る

ことを特徴とする請求項 1 記載の回路基板検査装置。

【請求項 5】 前記支持基板は、前記回路基板とほぼ同じ大きさから成る

ことを特徴とする請求項 1 記載の回路基板検査装置。

【請求項 6】 前記支持基板が前記回路基板と略平行に配置された状態で、前記支持基板における前記回路基板の所定の部品の位置と対応する位置に、前記部品との接触を回避する孔が形成されている

ことを特徴とする請求項 1 記載の回路基板検査装置。

【請求項 7】 前記支持基板は箱体に組立自在に設けられており、箱体に組み立てた状態では前記回路基板を囲むよう配置される

ことを特徴とする請求項 1 記載の回路基板検査装置。

【請求項 8】 前記コイルは、前記回路基板の外周に対応するよう前記支持基板に巻回されている

ことを特徴とする請求項 2 記載の回路基板検査装置。

【請求項 9】 前記コイルは、前記部品の外周に対応するよう前記支持基板に巻回されている

ことを特徴とする請求項 2 記載の回路基板検査装置。

【請求項 10】 前記コイルは、前記部品の端子の位置に対応するよう前記支持基板に巻回されている

ことを特徴とする請求項 2 記載の回路基板検査装置。

【請求項 11】 前記コイルは、前記回路基板の入出力コネクタの位置に対応するよう前記支持基板に巻回されている

ことを特徴とする請求項 2 記載の回路基板検査装置。

【請求項 12】 前記コイルは、前記回路基板が複数ある場合の回路基板間を接続するケーブルの位置に対応するよう前記支持基板に巻回されている

ことを特徴とする請求項 2 記載の回路基板検査装置。

【請求項 13】 前記コイルは、前記回路基板が複数接続されてなる回路基板群の外周に対応するよう前記支持基板に巻回されている

ことを特徴とする請求項 2 記載の回路基板検査装置。

【請求項 14】 前記インピーダンス成分は容量成分で構成されている

ことを特徴とする請求項 3 記載の回路基板検査装置。

【請求項 15】 前記インピーダンス成分はインダクタンス成分で構成されている

ことを特徴とする請求項 3 記載の回路基板検査装置。

【請求項 16】 前記インピーダンス成分は抵抗成分で構成されている

ことを特徴とする請求項 3 記載の回路基板検査装置。

【請求項 17】 前記インピーダンス成分は、前記回路基板の配線と方向と略直交するよう前記支持基板に配置されている

ことを特徴とする請求項 3 記載の回路基板検査装置。

【請求項 18】 前記信号変化検出手段は、前記支持基板の複数層に跨って配置されている

ことを特徴とする請求項 1 記載の回路基板検査装置。

【請求項 19】 前記コイルは、前記支持基板の複数層の各々に均等な巻線数で跨って形成されている

ことを特徴とする請求項 2 記載の回路基板検査装置。

【請求項 20】 前記容量成分は、前記支持基板の複数層のうち 2 つに設けられた電極から構成されている

ことを特徴とする請求項 14 記載の回路基板検査装置。

【請求項 21】 前記信号変化検出手段が複数設けられている場合、各信号変化検出手段の片方の端子を共通で接続する

ことを特徴とする請求項 1 記載の回路基板検査装置。

【請求項 22】 前記各信号変化検出手段の片方の端子を共通するにあたり、その共通の端子を前記支持基板の外部で接地する

ことを特徴とする請求項 21 記載の回路基板検査装置。

【請求項 23】 前記各信号変化検出手段の片方の端子を共通するにあたり、前記支持基板の端部で共通接続する

ことを特徴とする請求項 21 記載の回路基板検査装置。

【請求項 24】 前記信号変化検出手段が複数設けられている場合、各信号変化検出手段の端子を接近させた状態で略平行にして前記支持基板に引き回す

ことを特徴とする請求項 1 記載の回路基板検査装置。

#### 【発明の詳細な説明】

##### 【0001】

#### 【発明の属する技術分野】

本発明は、電子回路の異常、故障状態の検出、診断を行う装置に関し、例えば PWB A と称する複数の回路基板が接続されて形成される電子回路で構成されている機器において、電子回路の動作、性能の異常、故障を予測、検出し、あるいは予防する回路基板検査装置に関する。

##### 【0002】

#### 【従来の技術】

パーソナルコンピュータ、複写機等の電子機器には、近年、性能、機能の向上に伴い、益々、それらを実現するための様々な用途のアナログ、及びデジタルの

電子回路がプリント基板の形で格納されてきている。また、自動車や航空、ロボットや半導体設計装置等、他の産業機器においても動作制御等の手段として、信頼性が高く、高速・高精度での動作が可能な電子回路基板が数多く搭載されている。これらの電子回路基板は一連の機能を実現するために、様々な形でケーブルを介して接続されることにより、所望のスペックが実現されている。

#### 【0003】

このような基板が搭載される機器が使用される環境は、通常はオフィス内であったり、家屋内であったりするが、それ以外にも過酷な環境下で使用される場合もあり、非常に多岐にわたっている。特に使用環境が劣悪である場合には、通常の方法で使用していたとしても、様々な状態の検出が困難な異常、故障が発生し、その修復には多大な労力を要することになる。

#### 【0004】

また、通常の使用環境下で使用している場合でも、電子回路の異常、故障は発生し、その頻度は必ずしも低いとは言えず、検出箇所を特定できないこともしばしば生じていた。さらに、電子回路基板に異常が発生した場合には、安全性やコストなどの面から早急な対応が必要でもあった。

#### 【0005】

上述した対応の一例として、複写機やプリンタ等の異常、故障情報の連絡が入った場合、修理担当者が現地に駆けつけて機器に記録されている故障箇所情報や故障履歴の情報等をもとに故障部位の特定を行い、交換する、あるいは修復作業を行う、などの措置手段を講ずることがある。

#### 【0006】

あるいは、これらの機器がネットワークに接続されており、自動的にこれらの情報を管理する部署へ、状態の管理や故障情報等を伝送する場合には、これらの情報をあらかじめ解析した上で、修理担当者により、同様の措置が取られる。

#### 【0007】

しかし、上述のような異常、故障が発生した場合には、通常、機器は使用不可能となり、ダウンタイムが生じてしまう、というユーザ側にとってのデメリットが発生する。



**【0008】**

また、メーカ側にとっても、故障部位の特定に手間取ったり、故障部位が必ずしも正確に特定できるとは限らず、故障と考えられる部分を全て交換する等の措置により、多大なコストが発生したり、あるいは修理そのものに時間がかかってしまう、マンパワー的な対応がおいつかない、といったような状況が発生している。従って、ユーザ側／メーカ側双方に取り、多大な損失を被る状況が多発しているという事実がある。

**【0009】**

そこで、故障部位を特定したり、発生自体を予測する場合、故障箇所を特定する精度を上げたり、特定するまでの時間的なロスを削減する、異常、故障状態をもれなく把握する、これらの構成を簡単かつ低コストで実現する、といった方法について様々な試みがなされている。

**【0010】**

例えば、非特許文献1では、ターゲットとする配線を流れる電流から発生する磁場を検出する超小型でかつ独自の形状を有する磁界検出プローブを用いた非接触方法により、基板の配線を非接触スキャンする方式によって、現状の高密度配線プリント基板における配線の断線、線幅異常を主に、ICの故障等も含めた基板で発生する異常を検出する手法を、高速かつ機械的なストレスのない状態で実現しようとしたものである。

**【0011】**

また、特許文献1では、各電子基板の電源電流を電源に並列接続した抵抗に流し、その両端の電位差から夫々の電子基板の電流情報を読み取って通常状態と比較して故障を判別する、ことで実現しようとしている。

**【0012】****【特許文献1】**

特開平2000-74998号公報

**【非特許文献1】**

藤城 久、他2名、”渦電流探傷技術によるプリント配線の欠陥検出”、[online]、平成14年、金沢大学工学部、[平成14年12月4日検索]、イ

ンターネット<URL:http://magmac1.ec.t.kanazawa-u.ac.jp/magcap-j/research-j/ecta-j.html>

### 【0013】

#### 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、このような回路基板検査装置においては次のような問題がある。すなわち、非特許文献1で開示される技術では、回路基板上の信号線の状態や電流から発生する磁界を非接触のまま高精度にセンシングすることは可能であるものの、磁界をセンシングする手段として使用する専用プローブは高価であり、故障検出コストがかかる。しかも一度に測定できる領域はピンポイントであるため、回路基板全体にわたって故障を検査するためには多大な時間が必要になる、あるいは手間がかかるという問題が生ずる。

### 【0014】

また、特許文献1で開示される技術では、センシング部を回路基板設計時に組み込むなどして固定的に使用する必要があり、構成の柔軟性に乏しい、という問題が発生する。

### 【0015】

#### 【課題を解決するための手段】

本発明はこのような課題を解決するために成されたものである。すなわち、本発明は、所定の部品や配線が形成されて成る回路基板の動作を検査する回路基板検査装置において、回路基板の部品実装面と略平行に配置される支持基板と、支持基板が回路基板と略平行に配置された状態で、支持基板における回路基板の部品もしくは配線と対応する位置に配置される信号変化検出手段とを備えている。

### 【0016】

このような本発明では、支持基板における、回路基板の部品もしくは配線と対応する位置に信号変化検出手段が配置されていることから、この信号変化検出手段が配置された支持基板を回路基板と略平行に配置することで部品もしくは配線に対応して信号変化検出手段が位置合わせされ、回路基板に実装される部品や配線の検査を容易かつ的確に行うことができるようになる。また、回路基板に予め信号変化検出手段を組み込む必要がなく、支持基板に信号変化検出手段を配置す

るため、検査対象となる回路基板の部品レイアウトに合わせて信号変化検出手段を配置でき、既存の回路基板への対応も可能となる。

#### 【0017】

##### 【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を図に基づき説明する。図1、図2は、本実施形態に係る回路基板検査装置を説明する図、図3は、検査を説明する図である。すなわち、本実施形態に係る回路基板検査装置は、所定の部品3や配線が形成されて成る回路基板1の動作を検査するためのものであり、この回路基板1の部品実装面と略平行に配置される支持基板4と、支持基板4が回路基板1と略平行に配置された状態で、支持基板4における回路基板1の部品3もしくは配線と対応する位置に配置される信号変化検出手段（コイル5やコンデンサ6）とを備えて構成されている。

#### 【0018】

信号変化検出手段としては、部品3や配線を流れる電流から発生する磁界によって誘導起電力を発生するコイルであったり、電流配線を流れる信号変化によって電位情報を生じさせるインピーダンス成分（容量成分やインダクタンス成分、抵抗成分で構成されるもの）から成る。

#### 【0019】

この回路基板検査装置を実現するには、支持基板4として平面状の絶縁性の板であるフレキシブル（可撓性）基板を用い、コイル5やコンデンサ6をその上に形成する。図1（a）では回路基板1上に配置されているコネクタ2の周辺や回路基板1の外周を包囲するようコイル5が配置されたり、特定の部品3（例えば、集積回路）の周囲を包囲するようコイル5が配置されている。また、特定のコネクタ2に接続される入出力配線群に直交するように容量成分として機能する構成（例えば、コンデンサ6）が配置されている。

#### 【0020】

フレキシブル基板から成る支持基板4は、適用する回路基板1と縦横略同サイズであり、回路基板1とフレキシブル基板とを略平行に重ねた時に、フレキシブル基板上に形成されているコイル5やコンデンサ6が、ちょうど所望の箇所へあ

てがわれるような位置にくるように配置する。このようにして、配置された各部からの電氣的な信号は信号取り出し部 7 へと接続され、そこから外部へ取り出すようにする。

#### 【0021】

コイル 5 やコンデンサ 6 から成る信号変化検出手段が複数ある場合には、各信号変化検出手段の片方の端子を支持基板 4 の端部で共通接続してもよい。また、共通で接続された端子を支持基板 4 の外部で接地するようにしてもよい。さらに、各信号変化検出手段の配線は、近接させた状態で略平行にして支持基板 4 を引き回すようにする。このような配線によってコイル 5 やコンデンサ 6 による信号変化を精度良く捉えることが可能となる。

#### 【0022】

また、支持基板 4 における信号変化検出手段を配置しない部分で、支持基板 4 を回路基板 1 に近接させる際に干渉してしまう部品がある場合、その部品と対応する支持基板 4 の位置に孔（図示せず）を設けておき、部品と支持基板 4 とが接触しないようにすることもできる。

#### 【0023】

図 1 (b) は回路基板へ適用する他の形態を示している。回路基板 1 単体ではなく、複数の回路基板 1 が接続されてなる回路基板群へ適用する場合、各回路基板 1 間を接続するケーブルも含め、図に示したように同サイズのフレキシブル基板から成る支持基板 4 を回路基板群と略平行に近接して固定し、上述した手法により各部の状態を検出する。

#### 【0024】

また、図 1 (c) は、形成されるコイルの他の形状を示している。これは支持基板 4 に直に形成する場合でも同じであるが、回路基板 1 を駆動しているときに発生する磁界のうち、回路基板 1 と平行に生じている部分をセンシングする場合に用いるものである。したがって、コイル 5 は支持基板 4 の表裏に形成される信号層 10、11 にかかる厚さ方向の二次元を利用して形成される。

#### 【0025】

図 1 (d) は、支持基板 4 上に形成されるコンデンサ 6 の構成例である。支持

基板4の信号層10、11両面に、所望の面積の電極を形成してコンデンサ6を構成し、各電極に接続された信号線を信号取り出し部7まで接続することにより、クロストークの結果、電極間で発生する電位情報を抽出する。図1(e)は、図1(d)を実際に配線群上へあてがった場合の等価回路である。

#### 【0026】

図2(a)は例えば4巻きコイル5を2個と図示したサイズのコンデンサ6を支持基板4へ構成した状態を示す図である。支持基板4は、厚さ方向に対して、中央部に絶縁層を設け、その両面に信号層を設ける構成とし、外部との電氣的接触を避ける場合には絶縁樹脂等でコーティングする。

#### 【0027】

コイル5は両信号層に2巻きずつ同じ方向に回転するようにして形成し、両層の間をスルーホール12で接続する。したがって、図2(a)では2巻きコイル配線が形成されている層の反対側の層に形成されている2巻きコイル(図の一点斜線)へ実線で示されている2巻きコイルからスルーホール12を介して接続される。

#### 【0028】

そして、コイルが2回転したところで再びスルーホール12を介して表層へと導かれる。コイル5の両端に接続された配線15は、二本対になるようにして並行して信号取り出し部7近傍まで配線され、片方の配線が再びスルーホール12を介して別の層へ移り、そこで他の信号線対の片方の配線と接続され、それが信号取り出し部7を介して抽出される。もう片方の配線はそれぞれが独立して信号取り出し部7から抽出される。

#### 【0029】

コンデンサ6も同様に、支持基板4の表裏に形成された電極対に各々配線14が接続され、一方の配線がスルーホール12を介して反対の層へ導かれている。そして、この配線14を平行させて配線対16とし、信号取り出し部7まで引き回されている。

#### 【0030】

図2(b)は、図2(a)の信号取り出し部7を介して取り出された信号を解

析し、回路基板に異常が発生しているかどうかを診断するプロセスを示すブロック図である。信号取り出し部7より送られてきた信号は、信号選択部21において任意の信号が選択される。

#### 【0031】

一方、記憶部22には、信号取り出し部7より取り出される各信号の正常状態を測定したデータが格納されており、信号選択部21において選択した信号の状態を正常状態と比較する比較照合部23でこれらの信号を比較することにより、その差異を抽出する。抽出された差異が正常状態と比較して同等の範囲にあるかどうかを診断する診断部24で、回路基板が正常に動作しているかどうかを診断する。

#### 【0032】

図3は、本実施形態の回路基板検査装置を用いた磁界情報の変化を説明する図で、誘導起電力を縦軸、時間を横軸にして示したものである。図3(a)は正常な状態で測定した結果を示したものであり、これが回路基板の一部に異常が発生することにより、図3(b)に示すように振幅が小さくなる結果が得られる。

#### 【0033】

したがって、所定の回路基板に故障が発生しているかどうかを診断することが可能となり、しかも回路基板の設計によらず、後から本実施形態の回路基板検査装置を付加することで対応でき、非常に柔軟性のある検出装置としての提供が可能となる。

#### 【0034】

##### 【実施例】

図4～図9は本実施形態の具体的な実施例を説明する図である。先ず、図4～図6を用いて第1の実施例について説明する。図4に示された各回路基板41、42、43に、先に説明した本実施形態の回路基板検査装置を近接して取り付ける。各回路基板検査装置には、回路構成に照らし合わせて符号411、412、413、414、415、416、417の周囲を包囲するようにコイルを形成する。

#### 【0035】

図5～図6は、夫々、基板41上の回路部412および基板42上の回路部414について、本実施形態の回路基板検査装置を近接した時にこれらの回路を包囲するようにして形成されたコイルによってセンシングされる磁場によって発生する誘導起電力波形を示したものである。

#### 【0036】

図5(a)、図6(a)は正常状態における波形であり、図5(b)、図6(b)は、断線異常45が発生した場合の波形を示している。各基板が正常に動作している場合には、基板41上の発信器44が発生するクロックによって動作する基板42上の回路部414について、これを包囲するようにして形成された支持基板上のコイルでセンシングした磁場によって発生する誘導起電力の時間的な変化は、図5(a)に示すように、周期T11の中に±V11、±V12、±V13の3つのピークを有する波形として観測される。

#### 【0037】

同様に基板41上の回路部412もまた、発信器44からのクロック信号によって動作し、これを包囲するようにして形成された支持基板上のコイルでセンシングした磁場によって発生する誘導起電力の変化は、図6(a)に示すように、周期T14の中に±V14、±V15の2つのピークを有する波形として観測される。

#### 【0038】

今、図に示したようにして接続されている各基板間で、基板41上で駆動する発信器より基板41から基板42に送られているクロック用のケーブルラインが基板42上で断線する異常45が発生したとする。

#### 【0039】

このとき、基板41上の回路部412は正常に動作しているため、コイルでセンシングする回路および周辺部の磁場には特に変化は観測されず、したがってコイルの両端に発生する誘導起電力波形もまた、図6(b)に示すように特に変化は見られない。

#### 【0040】

しかし、基板42上の回路部414は断線のため、回路動作に必要なクロック

信号が入力されず、回路が正常に動作しない。したがって、回路部 414 を包囲するようにして形成されたコイルから得られる誘導起電力波形は大きく変化し、図 5 (b) に示すように 3 つのピークを示す振幅が正常状態と比較して大きく下回る結果が得られる。

#### 【0041】

特に図示はしないが、他の回路部は特に影響がないため、回路部 412 を包囲するように形成されたコイルから得られる誘導起電力波形同様、正常状態と変化はない。これらの結果より、異常が発生しているのは基板 42 であると診断することが可能となる。

#### 【0042】

次に、別の故障状態を検出する実施例として、図 7～図 9 に沿って第 2 の実施例について述べる。図 7 は、第 2 の実施例を説明するための回路構成概略を示す図であり、各回路基板 71、72 および 73 とその接続等の構成および、各回路基板へ近接するフレキシブル基板の構成については、第 1 の実施例と同様である。ただし、各回路部の詳細な回路構成は異なっているものがあるものとする。

#### 【0043】

図 8～図 9 は、それぞれ基板 72 上の回路部 714 および基板 73 上の回路部 716 について、フレキシブル基板を近接した時にこれらの回路を包囲するようにして形成されたコイルによってセンシングされる磁場によって発生する誘導起電力波形を示したものである。

#### 【0044】

図 8 (a)、図 9 (a) は正常状態における波形であり、図 8 (b)、図 9 (b) は、回路部 716 内の領域 80 が動作しなくなる現象が発生した場合の波形を示している。

#### 【0045】

各基板が正常に動作している場合には、基板 71 上の発信器 74 が発生するクロックによって動作する基板 73 上の回路部 716 について、これを包囲するようにして形成されたフレキシブル基板上のコイルでセンシングした磁場によって発生する誘導起電力の時間的な変化は、図 8 (a) に示すように、周期 T21 の



中に±V21、±V22の2つのピークを有する波形として観測される。

【0046】

同様に基板72上の回路部714もまた、発信器74からのクロック信号によって動作し、これを包囲するようにして形成されたフレキシブル基板上のコイルでセンシングした磁場によって発生する誘導起電力の変化は、図9(a)に示すように、周期T24の中に±V24、±V25の2つのピークを有する波形として観測される。

【0047】

今、図7に示したようにして接続されている各基板間で、基板71上で駆動する発信器より基板71から基板72および基板73に送られているクロックを基準として駆動する回路部716内の領域80が動作しなくなる現象が発生したとする。

【0048】

このとき、基板72上の回路部714は正常に動作しているため、コイルでセンシングする回路及び周辺部の磁場には特に変化は観測されず、したがってコイルの両端に発生する誘導起電力波形もまた、図9(b)に示すように特に変化は見られない。

【0049】

しかし、基板73上の回路部716は回路部内で発生した異常のため、正常に回路が動作しておらず、正常状態のように磁場の発生原因である電流変動もまた正常ではない。

【0050】

したがって、回路部716を包囲するようにして形成されたコイルから得られる誘導起電力波形は大きく変化し、図8(b)に示すように2つのピークを示す振幅が正常状態と比較して大きく下回る結果が得られる。

【0051】

特に図示はしないが、他の回路部は特に影響がないため、回路部714を包囲するように形成されたコイルから得られる誘導起電力波形同様、正常状態と変化はない。これらの結果より、異常が発生しているのは基板73であると診断する

ことが可能となる。

#### 【0052】

なお、本実施例では、磁場をセンシングするコイルの設置位置を回路基板にフレキシブル基板を近接した際に回路部周囲にくるように配置したが、これはもっとも必要な情報をセンシングできる位置に設置することを意味している。

#### 【0053】

また、本実施例ではコイルを形成するものをフレキシブル基板とし、回路基板、ケーブル等に固定することを示唆したが、支持基板4となるフレキシブル基板を箱体に組立自在にしておき、検査対象となる回路基板やケーブルを箱体に組み立てた内部に収納して検査を行うようにしてもよい。

#### 【0054】

##### 【発明の効果】

以上で説明したように、本発明によれば、簡単な構成でかつ低コストで回路基板の故障を特定することが可能となる。また、本発明によれば、既存の回路基板に対してもその回路基板に実装される部品や配線の位置に対応して支持基板に信号変化検出手段を設けることで、回路基板の部品レイアウトに合わせた構成を容易に実現でき、所望の部品等の検査を的確に行うことが可能となる。

##### 【図面の簡単な説明】

【図1】 本実施形態を説明する図（その1）である。

【図2】 本実施形態を説明する図（その2）である。

【図3】 検査を説明する図である。

【図4】 第1の実施例を説明する図である。

【図5】 第1の実施例における検査を説明する図（その1）である。

【図6】 第1の実施例における検査を説明する図（その2）である。

【図7】 第2の実施例を説明する図である。

【図8】 第2の実施例における検査を説明する図（その1）である。

【図9】 第2の実施例における検査を説明する図（その2）である。

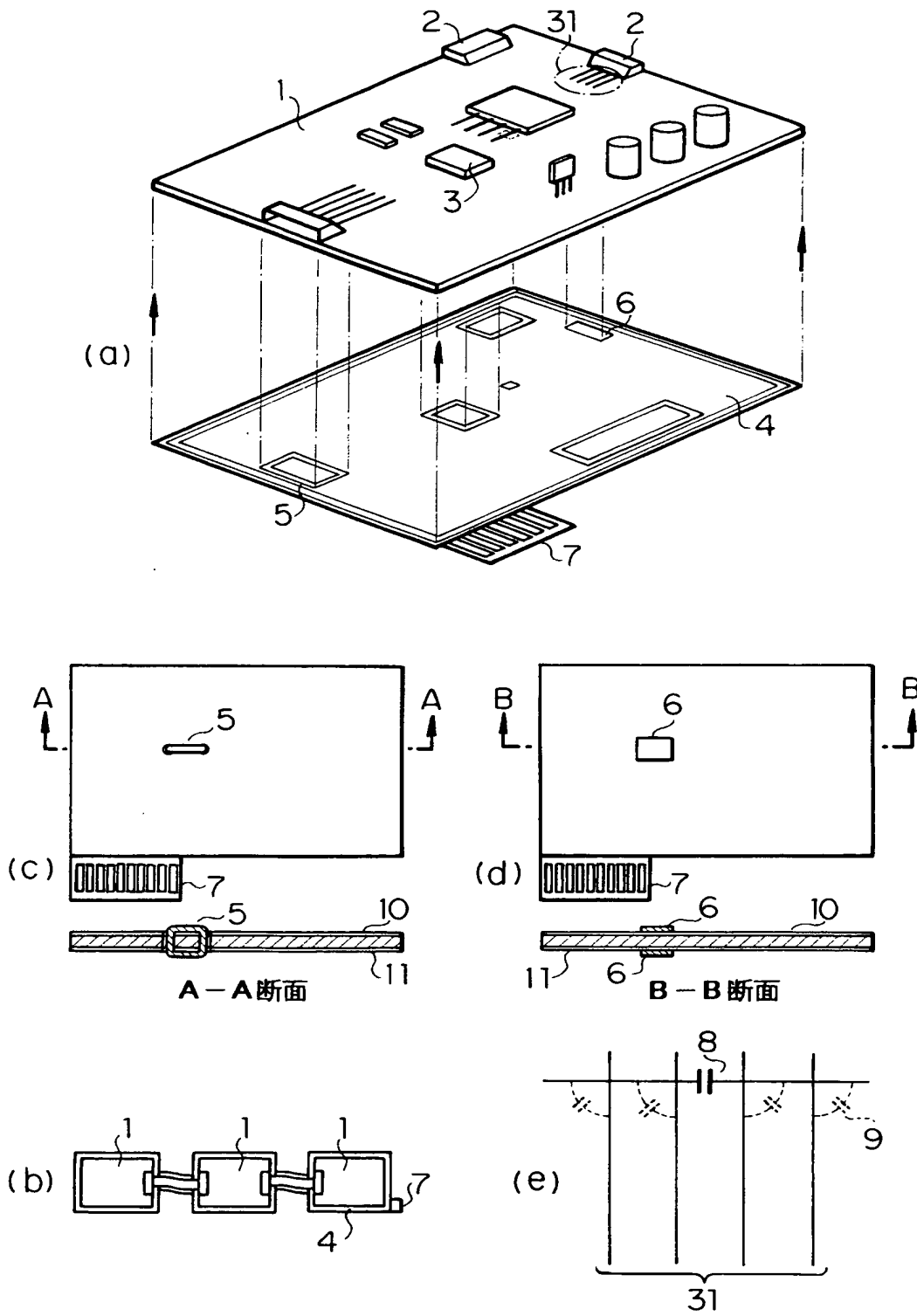
##### 【符号の説明】

1…回路基板、2…コネクタ、3…部品、4…支持基板、5…コイル、6…コ

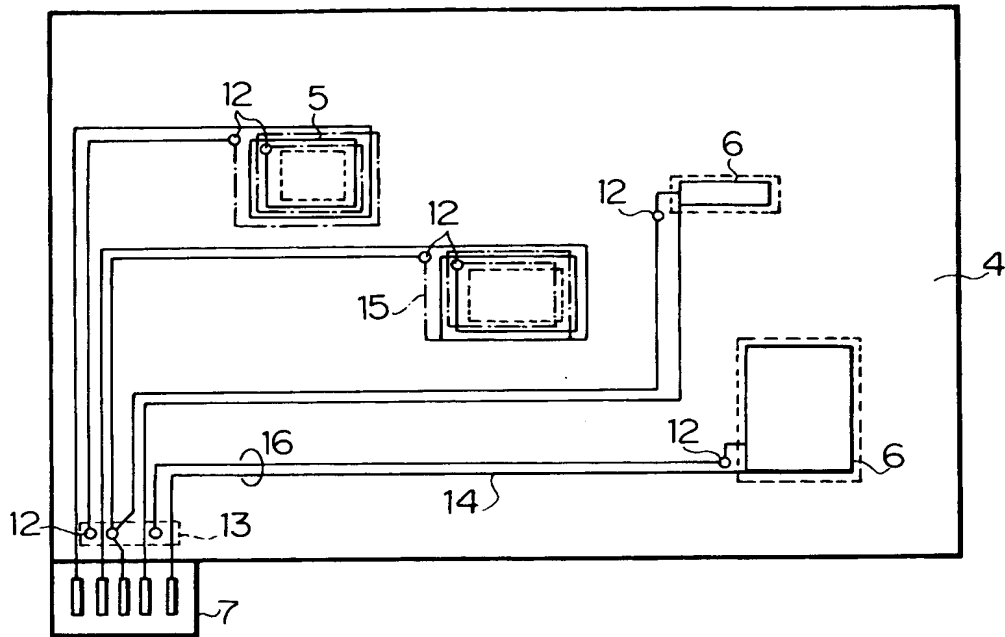
ンデンサ、7…信号取り出し部

【書類名】 図面

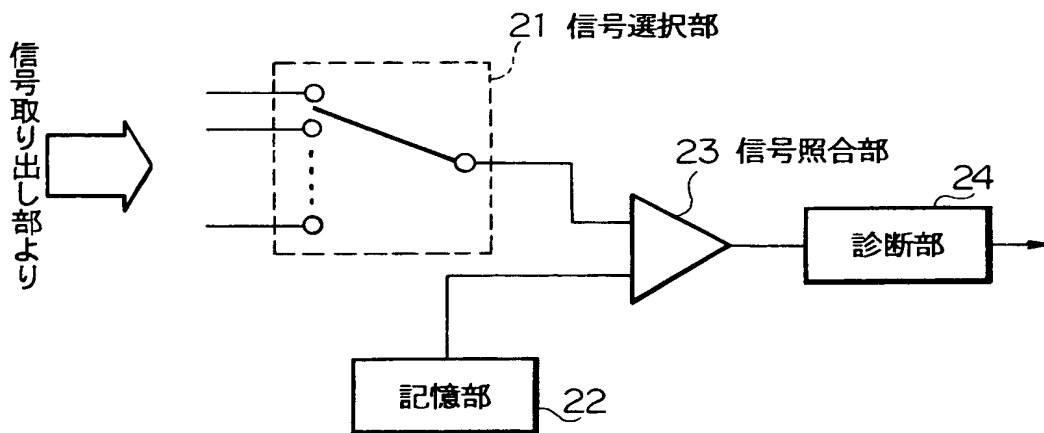
【図1】



【図 2】

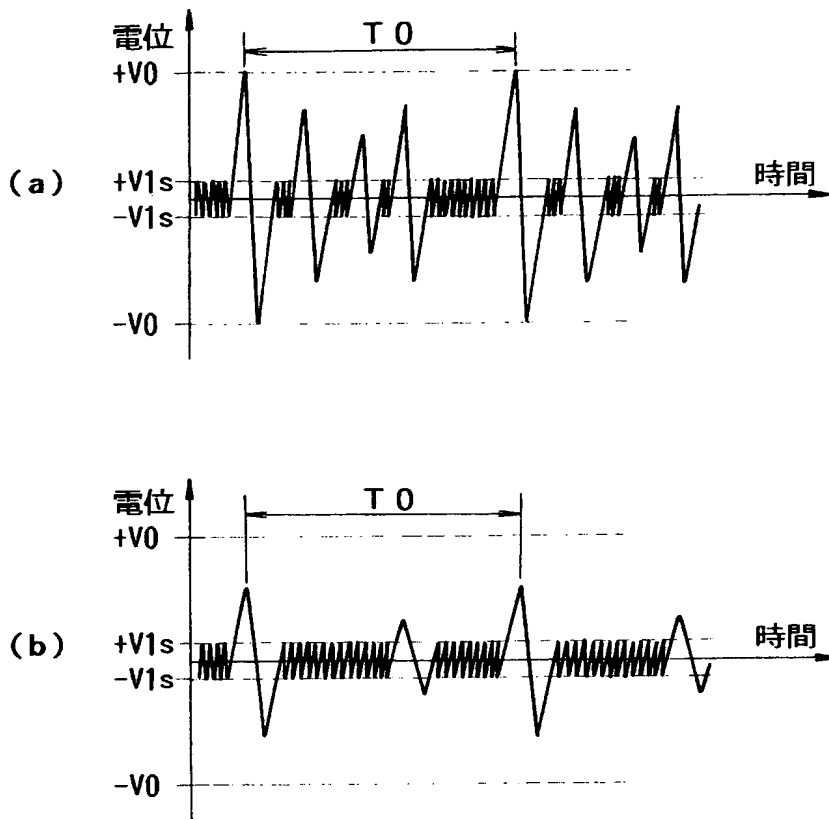


(a)

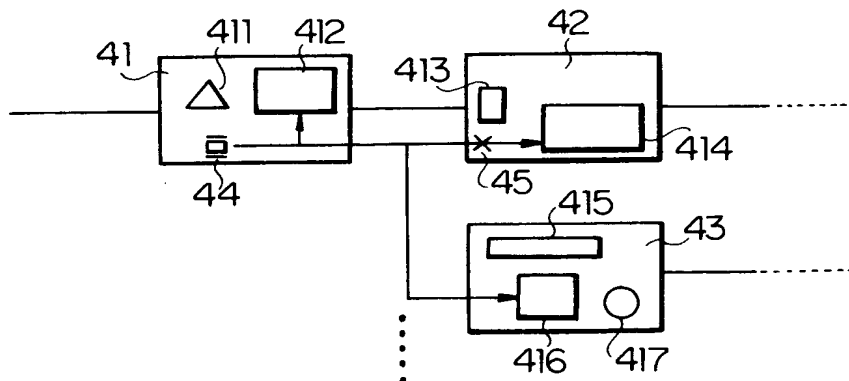


(b)

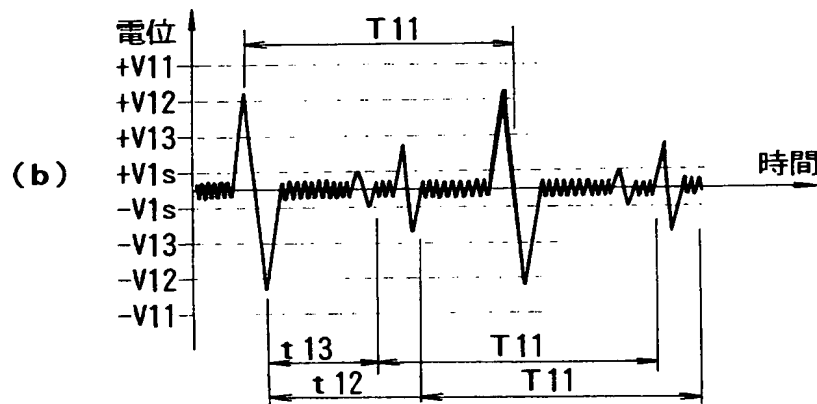
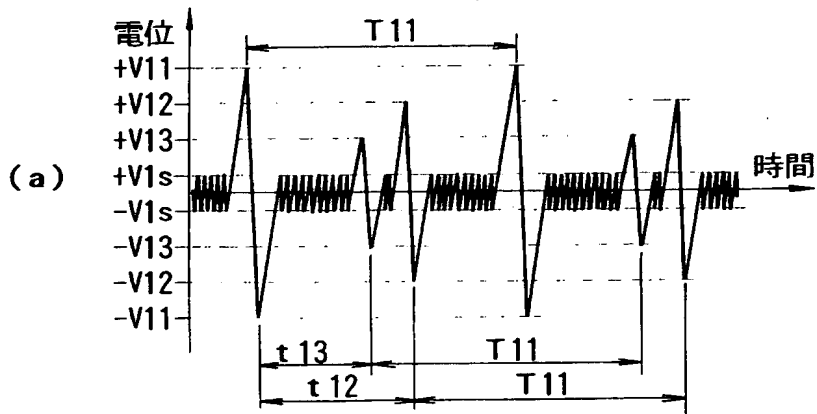
【図 3】



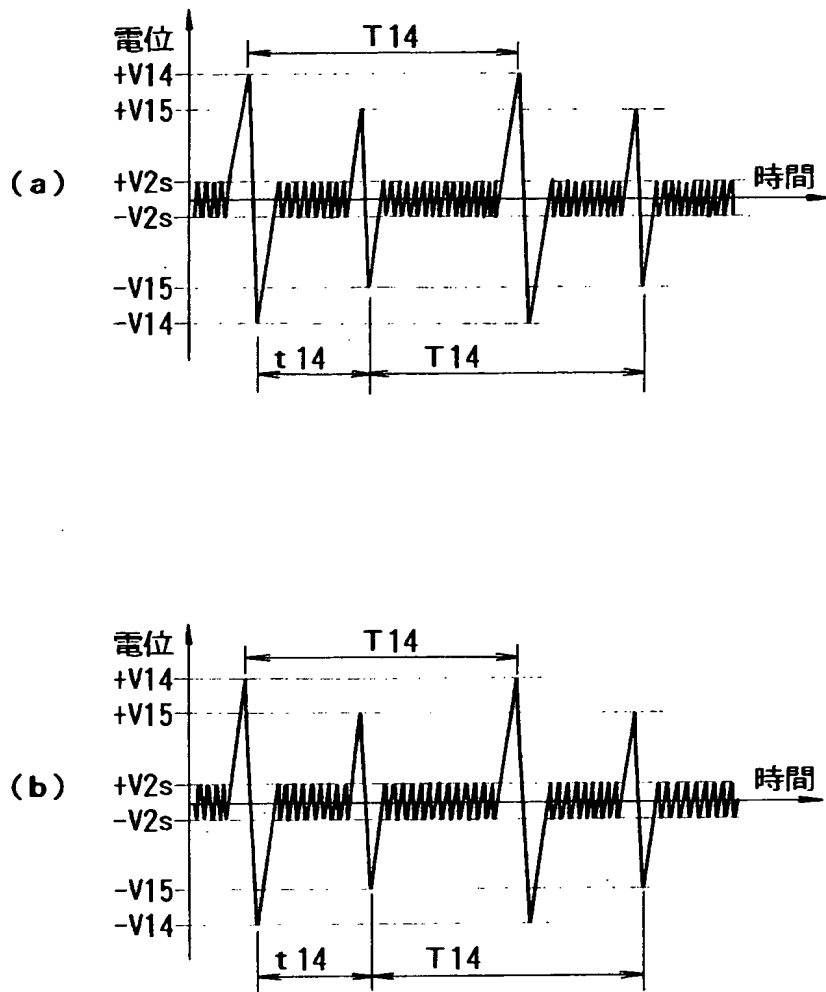
【図 4】



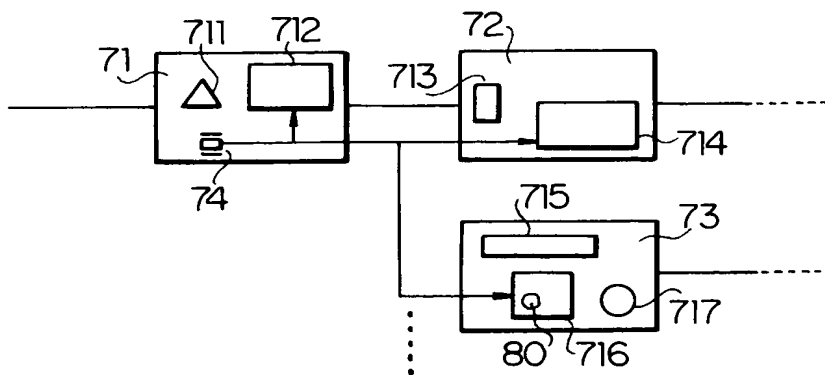
【図 5】



【図 6】

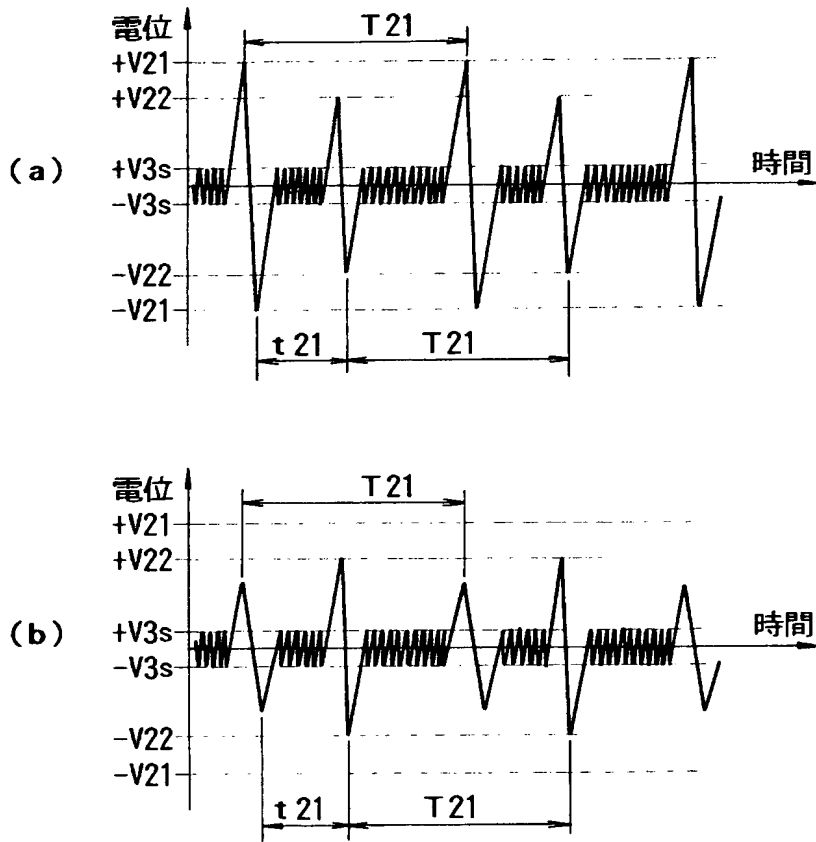


【図 7】

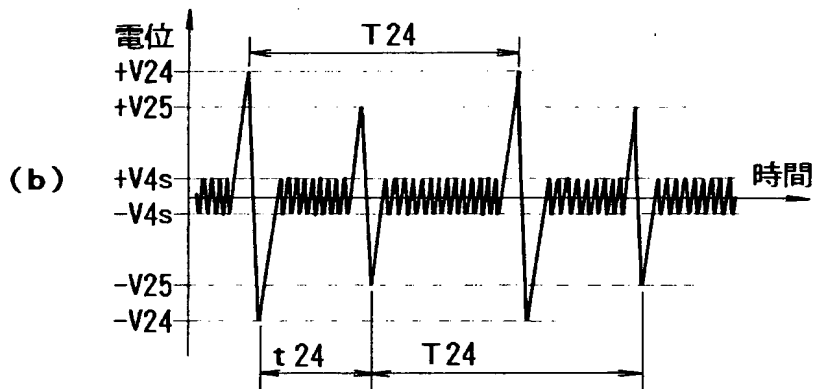
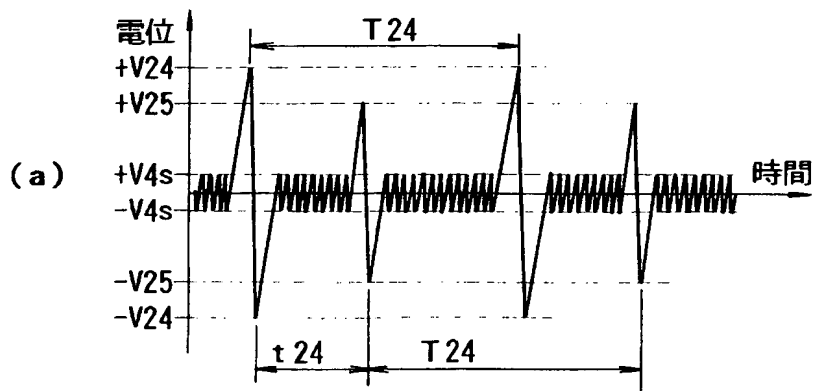




【図 8】



【図 9】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 回路基板の検査を行う装置の簡素化および的確な検査を行うことができる構成を提供すること。

【解決手段】 本発明は、所定の部品 3 や配線が形成されて成る回路基板 1 の動作を検査する回路基板検査装置において、回路基板 1 の部品実装面と略平行に配置される支持基板 4 と、支持基板 4 が回路基板 1 と略平行に配置された状態で、支持基板 4 における回路基板 1 の部品 3 もしくは配線と対応する位置に配置されるコイル 5 やコンデンサ 6 から成る信号変化検出手段とを備えている。

【選択図】 図 1

特願 2002-367791

出願人履歴情報

識別番号

[000005496]

1. 変更年月日

1996年 5月29日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都港区赤坂二丁目17番22号

氏 名

富士ゼロックス株式会社